

## SCHEDA TECNICA

### ZM-R750 SISTEMA AUTOMATICO DI REWORK PER PACKAGE BGA, LGA ,QFN ..

Sistema Automatico per la rilavorazione di schede SMT che montano dai micro chip al grid array di grandi dimensioni. La gestione dei profili è totalmente computerizzata. Telecamera e monitor con qualità HD totalmente motorizzata. Il pick up del componente avviene totalmente in maniera automatica attraverso coordinate preventivamente programmate. La testa di posizionamento è motorizzata su asse Z e Theta 360°.

#### Caratteristiche di base:

- Testa di reflow ad aria calda
- Preriscaldamento doppio (aria e IR)
- 5 Sensori controllo Temperatura
- Precisione sensore 2-3°C
- Allineamento ottico di precisione
- Telecamera HD 2Mp 5X-50X
- Rotazione 360° del posizionamento
- Asse Z motorizzato
- Telecamera asse Y e X motorizzato
- Pressione di posizionamento <0.2N
- Gestione chip da 80x80 a 3x3 mm
- PC Dell + Monitor



#### Specifiche Tecniche:

Alimentazione/Potenza Assorbita	380/220VAC 50/60 Hz Max 7500W totali
Potenza riscaldatori ad aria	Superiore 1200W, inferiore 1200W
Potenza pre-riscaldatore IR	4800W (IR 420x435 mm a riscaldamento rapido)
Temperatura dell'aria calda	400°C max, precisione 2-3°C (5 porte sensori)
Posizionamento	Portaschede anti fold, puntatore laser
Precisione Allineamento	Tipicamente 0,01mm
Min / Max dimensione della scheda	6 x 6 mm / 632 x 520 mm spessore max 8 mm
Adatta per componenti	BGA, QGN, SCP, POP, QFN, LED, chip SMD
Min / Max dimensione dei componenti	3.0 x 3.0 mm / 80 x 80 mm
Dimensioni e peso	1000 (L) x 840 (P) x 950 (H) mm, 130KG

## DATA SHEET

### ZM-R750 AUTOMATIC REWORK SYSTEM FOR PACKAGE BGA, LGA ,QFN ..

Automatic System for the rework of SMT boards that mount from microchip to great dimensions grid array. Profile management is totally computerized. Fully motorized HD quality camera and monitor. The Picking of the components occurs completely automatically through previously programmed coordinates. The positioning head is motorized on Z axis and Theta 360°.

#### Basic Features:

- Hot air reflow head
- Double preheating (air and IR)
- 5 Sensors for Temperature control
- Sensor accuracy 2-3°C
- Precision Optical Allignment
- 2mp 5X-50X HD camera
- 360°C rotation of positioning
- Motorized Z axis
- Motorized Y and X axis camera
- Positioning pressure <0.2N
- Chip management from 80x80 to 3x3 mm
- Dell PC + monitor



#### Technical Specifications:

Power Supply/Power Consumption	380/220VAC 50/60 Hz Max 7500W
Power air heaters	Upper 1200W, Lower 1200W
IR pre-heater Power	4800W (IR 420x435 mm fast heater)
Hot Air Temperature	400°C max, accuracy 2-3°C (5 Sensors)
Positioning	Anti-fold board holder, Laser pointer
Alignment Accuracy	Typically 0.01mm
Min/Max Board Dimensions	6 x 6 mm / 632 x 520 mm, thickness max 8 mm
Suitable for components	BGA, QGN, SCP, POP, QFN, LED, chip SMD
Min/Max Components Dimensions	3.0 x 3.0 mm / 80 x 80 mm
Dimensions and Weight	1000 (L) x 840 (D) x 950 (H) mm, 130KG